

赛晶科技集团有限公司 2024 年年度业绩发布会会议纪要

会议时间：2024 年 3 月 20 日

会议地点：香港金钟道 88 号太古广场 JW 万豪酒店三楼宴会厅

会议主题：赛晶科技集团有限公司 2024 年年度业绩发布

主办单位：赛晶科技集团有限公司

参会人员：投资人、分析师、嘉宾、公司管理层（董事长项颀先生、首席财务官薄祥鹏先生、董事长助理胡俊先生）

一、公司财务回顾

首席财务官薄祥鹏先生为大家介绍 2024 年年度业绩情况：

2024 年公司的销售收入达到了 16.1 亿元，与 2023 年的 10.5 亿元相比，增长了 53%。同时，公司的毛利率在销售收入大幅增长的情况下，由 2023 年的 31.8%增加了 0.5 个百分点至 2024 年的 32.3%。由于销售收入的大幅增长和毛利率的提升，公司的毛利润从 2023 年的 3.3 亿元增加 55%至 2024 年的 5.21 亿元。

从公司分行业的销售收入情况来看，公司整体的销售收入为 6.1 亿元，与去年相比增加 53%。其中，贡献最大的是常规的直流输电和柔性直流输电，其销售收入从 2023 年的 0.52 亿元增加 157%至 2024 年的 6.48 亿元。同时，新能源发电和储能方面的收入从 2023 年的 1.8 亿元增加 52%至 2024 年的 2.73 亿元。

随着公司销售收入的大幅增加，公司各项费用均有所上升，但在销售收入中的比重均有所下降。其中，销售费用从 8400 万元增加至 1.06 亿元；行政费用从 1.38 亿元增加至 1.6 亿元；财务费用从 1100 万元增加至 1800 万元。同时，公司继续加大在研发方面的投入，研发支出从 2023 年的 1.24 亿元增加至 2024 年的 1.47 亿元。

2024 年公司归属于股东的净利润为 1.02 亿元，与 2023 年的 3100 万元相比，增加了 225%。由于公司净利润的大幅增长，公司的基本每股收益、净利润率、净资产收益率等指标在 2024 年与 2023 年同期相比均有了明显提升。

二、公司业务回顾及展望

董事长项颀先生为大家介绍：

（一）特高压项目与直流输电业务

接下来我国的特高压项目会大幅增长，其中柔性直流的份额会大幅上升。由于行业特点，一般交货期长达十个月以上，一季度以后招标的项目交货基本都会在第二年度完成。2024 年公司主要交付的是 2023 年启动的直流项目，而 2025 年将会启动多个项目，其中大部分是柔性直流项目，这为公司的长期快速发展奠定了基础。

在常规直流方面，公司主要提供阳极饱和电压器和电力电容器，单条线路收入在一亿左右。而在柔性直流方面，单个项目的交付金额会大幅提升，比原来提高 500%以上。

（二）柔性直流技术研发与应用

本公司在柔性直流方面研发的新产品和技术：1、直流支撑电容器。该产品从 2017 年开始研发，今年获得了国家级的重大技术装备认定，是国内第一个通过第三方 IEC 全国测试的国产产品、第一个批量工程应用的国产产品、第一个百分之百替代进口的国产产品。在甘肃到浙江的世界首个柔性特高压直流输电项目中，该产品的国产化率为 30%，其中本公司的市场份额超过 60%。此外，本公司还在智能电网的在线监测方面有所布局，利用人工智能提高数据分析能力和诊断决策能力，提升电力系统维护的数字化和智能化水平。

（三）国际业务拓展

全球电力需求和电力基建需求旺盛，公司在 2024 年成立了国际业务部，加强国外市场业务推广。国外市场业务有两种模式，一种是我们通过当地的代理或者合作方客户直接在国外进行销售，还有一种间接销售是跟随央企一起去获取这些海外的项目。

2024 年，公司国外直接销售和间接销售总金额达到 2.4 亿多元，占总收入的 15%以上，同比增长 207%。涉及的国外项目包括德国 BorWin6 的海上风电项目、巴西伊泰普直流输电工程和沙特的柔性直流输电工程等。公司 2025 年计划交付和潜在的项目有沙特中南部的柔性直流输电工程、巴西美丽山特高压直流输电工程等。

（四）半导体业务

功率半导体行业的特点：第一，新产品的研发周期长，研发流程复杂，对性能要求高；第二，客户的导入周期比较长，整个的测试周期非常长，供应商考核谨慎，基本上各个行业导入周期都在一年到三年不等；然后，不同行业和客户的需求多样，差异性大。另一方面，一旦客户导入完成之后，受益周期长，客户粘性高。

本公司在碳化硅芯片和 IGBT 芯片研发方面取得进展，碳化硅芯片已成功在欧洲流片，是电动车主驱用的 13 毫欧的碳化硅芯片，达到了国际领先的水平。IGBT 芯片方面，成功研发出了基于第七代微沟槽技术的 1200V 芯片。1700V 芯片也在第三季度推出。我们还研发了一系列的小电流的芯片。公司在芯片研发方面不断丰富产品线，满足自用和外销需求。模块方面，我们已经研发完成了一系列新型号，满足更多的市场和客户需求。

2024 年，半导体业务客户导入取得增长。芯片客户从 3 家增加到 14 家，模块客户从 18 家增加到 46 家，覆盖多个行业，获得良好市场口碑。SVG 领域，我们是这个领域的领军企业，已经覆盖了 70% 的客户。在这一领域的国产产品中，市场份额排名前二。在储能领域，我们也获得良好的口碑。尤其高压级联储能领域的全部主流企业都已经开始导入本公司的产品。商用车某头部电驱企业已经导入完成，正在进行路测。在电阻焊机领域市场排名第一、第二的客户也都采用本公司的产品。

尽管 2024 年上半年半导体业务受疫情影响下滑，但下半年开始快速增长，2025 年销售目标定为 1.5 亿元。

四、问答环节

以下是现场提问环节中的部分问题及回答：

（一）常规特高压直流和柔性直流输电

问题：赛晶的收入很大一部分来自于常规特高压直流和柔性直流，这一块业务未来几年前景如何？

回答：截止到去年，中国一共建设了 39 条特高压直流和交流工程，但在十五五规划中就规划了 40 条特高压项目，其中特高压直流会达到二十条，常规直流适合稳定的发电电源如水电火电，同时要求送出端的区域电网比较强大。在新能源占比大幅提升的背景下，柔性直流是最合适的技术，柔性直流同时还可以解决同一区域内多条直流

换相失败的问题，可以组建区域的直流网，今后的直流项目大部分会是柔性直流。

(二) 柔性直流支撑电容产品

问题：赛晶柔性直流支撑电容产品目前行业地位怎样，发展前景如何？在柔性直流领域还有哪些产品和技术储备？

回答：柔性直流的支撑电容是在柔性直流项目中除 IGBT 外的另一项核心元器件，以往技术掌握两三家欧洲公司手中。赛晶是这一领域的先行者，从 17 年启动研发以来，到 2024 年，我们成为了首个 100%替代进口的国产企业。在四川构网型 SVG，玉环低频输电等项目中，我们的产品都是实现了全部国产替代。在国内首个±800KV 的特高压柔性直流输电工程 - 甘肃至浙江项目中，定了百分之三十的国产化比例，在四家国产化公司中赛晶独得 60%以上的市场份额，彰显了国家电网对赛晶产品性能和技术的肯定。随着国产化率的提升，这块业务相信会走上高速发展的道路。

随着特高压柔性直流输电的容量越来越大，项目中使用的 IGBT 和直流支撑电容越来越多，如何保证设备长期安全可靠运行，成为迫在眉睫的问题。未来国网要求对每只 IGBT 和电容的运行状态进行在线监测，在世界首条特高压柔性直流输电“甘浙”项目中，将试装一万个在线监测装置，由赛晶科技旗下武汉郎德研发制造，柔直的在线监测装置会成为赛晶另外一个业务的快速增长点；

(三) 半导体的优势及未来展望

问题：请问赛晶半导体的主要竞争优势有哪些，国内外主要的竞争对手有哪些？未来的业务展望怎样？

回答：赛晶半导体的主要优势是具有国际一流的研发团队，产品性能和可靠性、一致性居于国际领先水平。

目前在储能，集中式光伏，SVG 领域积累了良好的口碑和形象。

目前 IGBT 芯片已经研发了国际最新一代的 IGBT 微沟槽芯片，今年开始给客户送样，主要希望突破领域是组串式光伏，风电和八百伏电池系统的电动车领域；

碳化硅在欧洲流片完成最先进的 13 毫欧电动车主驱的碳化硅芯片，今年主要任务是在国内完成流片和量产；

经过几年持续不懈的研发，公司到今年年底的芯片和模块产品将能覆盖中压领域的

大多数应用。IGBT 和碳化硅的特点就是研发周期长，研发投入大，客户导入周期长，赛晶半导体应该已经顺利度过第一阶段，步入快速发展期。

（四）自研功率半导体业务竞争格局

问题：自研功率半导体业务在国内行业竞争激烈，怎么看待今年的竞争格局？

回答：中国是 IGBT 最大应用市场，但国产化率较低，尤其在高端领域供不应求。公司认为电力电子化趋势不可逆转，对 IGBT 行业前景坚定看好。尽管行业竞争激烈，但通过优胜劣汰，能够坚持下来的企业会得到很大发展。

（五）国外业务拓展与增长情况

问题：国外业务拓展的增长情况如何？主要项目来源有哪些？国外业务的盈利能力与国内业务相比如何？

回答：公司国外业务通过两种模式开展，一是间接销售，即与国家电网等央企合作，二是通过代理和直接销售。2024 年海外业务增长显著，预计 2025 年也会有不错的表现。公司还积极拓展与国外总包商的合作，并看好固态断路器等产品在海外市场的应用。

（六）服务器数据中心相关业务与战略考虑

问题：公司在服务器数据中心领域有没有相关业务或未来战略考虑？

回答：公司专门成立小组研究如何利用 AI 提高运营效率和生产管理水平，参与国家相关项目，关注设备在线监测和故障分析整合领域。此外，数据中心、人工智能等应有的发展将加大对电力的需求，并促进电网建设。这将有利于本公司的相关业务发展。

（七）分红情况

问题：我们注意到公司在 20 年以前都保持了良好的分红比例，之后几年停止了分红，今后几年的分红政策会是怎样？

回答：公司管理层一直致力于与所有股东分享公司的成长。今后五到十年，都会是赛晶的快速成长期，对固定资产投资和研发的投入，营运资金的要求都会保持高位，管理层将努力平衡好长期利益和短期利益的关系，在不影响公司发展的前提下，将每年

盈利的 10%-20%用于派息。

(八) 现金减少原因与现金流情况

问题：2024 年底现金及等价物减少约 4 亿元的原因是什么？公司现金流情况如何？

回答：由于业务和销售收入处于上升周期，对营运资金的需求显著增长。公司行业特点导致交货周期长，回款时间相应延长，但作为国家重点工程，回款有保障。截止 2024 年底，账面现金仍有 4 亿元以上，且资产负债率保持较低水平。我们相信目前公司的现金储备较为充足，可以满足后续营运需要。

(九) IGBT 和 SiC 模块生产线建设进度与盈利贡献

问题：第三条 IGBT 模块和第一条 SiC 模块生产建设进度如何？预计何时投产？产能释放后对公司业绩尤其是利润方面的贡献何时体现？这条产线的资本开支情况及未来计划目标是怎样的？

回答：SiC 模块已开始给客户送样，电动车领域导入周期较长。两条模块生产线，预计 2025 年底建完，2026 年投入使用。半导体毛利率与满产率关系密切，满产后成本将显著降低。生产线的资本开支，2025 年预计 1.5 亿左右，2026 年可能更低一点。

(十) 研发费用投入方向

问题：2024 年的研发费用增长 20%，主要投入在哪些方面？

回答：研发费用在直流业务和半导体业务方面均有投入，其中半导体占比最大。

(十一) 半导体团队优势与行业替代趋势

问题：半导体团队具有国际化和经验丰富特点，相对竞争对手有什么优势？如何看待今年碳化硅的渗透率提升和氮化镓应用对公司的影响？

回答：团队优势体现在行业经验和研发经验上，对新芯片研发的验证和测试有帮助。碳化硅在电动车领域渗透率提升，对公司是机遇，与 IGBT 在高电压领域长期共存。。氮化镓主要应用于低电压领域，公司没有计划开发相关产品。

(十二) 碳化硅芯片业务成本与利润影响

问题：上游碳化硅衬底价格持续下降，对公司碳化硅芯片业务的成本和利润端有何影

响？

回答： 碳化硅衬底价格下降使产品成本占比更合理，研发成本降低，利于产品导入市场，提升客户积极性。

五、会议总结

感谢各位的踊跃提问，也感谢我们的管理层，以及各位投资者、分析师和到场嘉宾的参与，赛晶科技集团有限公司 2024 年年度业绩发布会到此结束，非常感谢大家的参加！